



# NDST-SPT-200

## 导热硅脂



### 产品描述

NDST-SPT-200是一种具有超低热阻、易铺展特性，应用于高功率器件，如CPU，GPU，ASICs，北桥以及发热器件间。其优良的表面浸润性能，适用于丝网印刷方式较薄地涂覆于发热或散热器件间。同时，该款导热硅脂可通过各种工业可靠性测试，并可满足多种应用领域的使用要求。

### 特性与优点

- 高导热性能
- 低界面热阻
- 优异的可靠性

### 典型应用

- 手机数码设备
- 个人电脑、服务器
- 智能硬件设备

### 典型属性

| 属性                                                 | 典型值                                   | 测试方法                                                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 颜色                                                 | 白色、灰色、粉色、蓝色                           | 目视                                                                                              |
| 导热系数(W/m.K)                                        | 2.0                                   | HOT DISK                                                                                        |
| 热阻 ( $^{\circ}\text{C}\cdot\text{cm}^2/\text{W}$ ) | 0.35                                  | ASTM D5470, 40PSI@80°C                                                                          |
| 渗油率 (%)                                            | $\leq 1$                              | 评估导热材料在125°C、7D的质量减少                                                                            |
| 最小施工厚度 ( $\mu\text{m}$ )                           | $\leq 35$                             | -                                                                                               |
| 绝缘性 (Q.cm)                                         | $10^{12}$                             | IPC-TM-650 2.6.3.7, 85°C/85%RH 下监控绝缘电阻                                                          |
| 粘度 ( $\text{Pa}\cdot\text{s}$ )                    | $200 \pm 50$                          | 转子转速 0.1 RPM @20°C                                                                              |
| 锥入度                                                | $> 75$                                | GB/T269-91                                                                                      |
| 密度 ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )                      | $2.7 \pm 0.1$                         | ASTM D792                                                                                       |
| 离子含量 (ppm)                                         | F-,Cl-,Br-等卤素离子<br>总含量 $< 20\text{p}$ | MIL-STD-883 Method5011.4                                                                        |
| 腐蚀性                                                | 对 Cu、Ag 无腐蚀                           | ASTM D4048                                                                                      |
| 热阻可靠性                                              | 符合                                    | 温循 (-40-125°C) 1000cycles、高温 125°C 1000h 后，<br>无变粉、pump out、dry out 等失效现象。<br>热阻值增加 $\leq 15\%$ |
| 环保要求                                               | 符合                                    | RoHS2.0                                                                                         |
| 阻燃性                                                | V-0                                   | UL94                                                                                            |
| 保质期(月)                                             | 6个月                                   | 温度 $< 40^{\circ}\text{C}$ ，避免挤压、暴晒                                                              |